2011-2015年中国半导体材料深度分析与“十二五”发展趋势预测报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制
www.bosidata.com

报告报价

《2011-2015年中国半导体材料深度分析与“十二五”发展趋势预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：http://www.bosidata.com/xincailiao1105/A150437TAJ.html

【报告价格】纸介版6500元 电子版6800元 纸介+电子7000元

【出版日期】2011-05-09

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

博思数据研究中心 http://www.bosidata.com

报告说明:

博思数据研究中心发布的《2011-2015年中国半导体材料深度分析与“十二五”发展趋势预测报告》对我国半导体材料的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投 资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对半导体材料行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战 略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

半导体材料是电子信息产业基础的基础，对整个电子信息产业的发展起着重要的支撑作用。近几年，由于市场需求的不断扩大、投资环境的日益改善、优惠政策的吸引及全球半导体产业向中国转移等等原因，我国集成电路产业每年都保持30%的增长率。

然而，我国半导体材料仍不能满足产业需求，并且在当今节能减排、保护环境的大政策下，节能性功率器件及太阳能电池所用硅材料市场需求呈几何级数递增，3G和无线宽带、数字电视以及汽车电子等行业的快速发展仍将进一步加大国内对集成电路材料的需求。

第一章　“十一五”期间中国半导体材料发展环境及政策回顾
第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
一、2006年我国农业发展回顾
二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
三、2006年我国固定资产投资发展回顾
四、2006年我国国内贸易发展回顾
五、2006年我国对外经济发展回顾
六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
一、2007年我国农业发展回顾

二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
三、2007年我国固定资产投资发展回顾
四、2007年我国国内贸易发展回顾
五、2007年我国对外经济发展回顾
六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
一、2008年我国农业发展回顾
二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
三、2008年我国固定资产投资发展回顾
四、2008年我国国内贸易发展回顾
五、2008年我国对外经济发展回顾
六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
一、2009年我国农业发展回顾
二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
三、2009年我国固定资产投资发展回顾
四、2009年我国国内贸易发展回顾
五、2009年我国对外经济发展回顾
六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾

十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾

第二章　“十一五”期间中国半导体行业的发展概况分析
第一节　“十一五”期间全球半导体产业发展分析
一、全球半导体产业发生巨变
二、世界半导体产业进入整合期
三、全球半导体产业新进展
四、国际半导体市场增长减缓
第二节　“十一五”期间我国半导体产业分析
一、我国半导体产业简要分析
二、我国半导体产业局势良好
三、2008年我国半导体产业遭遇拐点
四、两化融合促进半导体行业发展
第三节　“十一五”期间中国半导体市场的发展概况
一、2008年我国半导体市场分析
二、我国半导体市场增速放慢
三、2008年我国半导体市场销售收入再次增长
四、我国半导体企业市场占有率偏低

第三章　“十一五”期间全球半导体材料发展概况分析
第一节　“十一五”期间国际半导体材料发展综述
一、世界半导体材料产业快速发展
二、世界半导体材料市场强劲增长
三、半导体材料市场再创新高
第二节　“十一五”期间美国半导体材料市场发展概况
一、美国开发出新型半导体材料
二、美国开发出的新材料可降低成本
三、美国利用钴绿开发新半导体材料
四、美国道康宁推出半导体材料发展新模式
第三节　“十一五”期间日本半导体材料市场发展概况
一、日本开发出微磁性半导体材料

二、日本开发出钻石半导体材料
三、日本有机半导体材料电子迁移率高
四、日本半导体材料巨头加大投资以增产
第四节　“十一五”期间中国台湾半导体材料的发展状况
一、2007年台湾跃登全球半导体材料第二大市场
二、台湾硅晶圆市场快速成长
三、台湾成为最大半导体设备投资市场
四、台湾建成半导体材料实验室

第四章　“十一五”期间中国半导体材料的发展分析
第一节　“十一五”期间中国半导体材料行业的发展综述
一、中国是最受关注的半导体材料市场
二、半导体材料的发展状况分析
三、半导体材料市场需求巨大
四、国产半导体材料新品不断
第二节　“十一五”期间中国半导体材料的研究应用状况
一、半导体材料的研究主题
二、我国半导体材料的研究进展
三、导体材料的应用分析
四、绿色半导体材料应用于高温汽车

第五章　“十一五”期间中国半导体硅材料市场发展概况分析
第一节　“十一五”期间中国硅材料业的发展概况
一、半导体硅材料在国民经济中的重要作用
二、我国硅材料行业的发展状况
三、半导体硅材料产业迅猛发展
四、我国半导体硅材料行业发展的新特点
第二节　“十一五”期间中国半导体硅材料发展中的问题
一、技术落后阻碍半导体硅材料发展
二、六大问题制约高纯硅材料产业发展
三、多晶硅价格居高不下给国内企业带来压力
第三节　“十一五”期间中国半导体硅材料的发展对策

一、加快半导体硅材料行业发展的建议
二、发展硅材料行业的策略
三、国内硅材料企业的竞争策略

第六章　“十一五”期间中国半导体材料相关行业分析
第一节　“十一五”期间半导体分立器件发展概况
一、半导体分立器件市场稳健发展
二、2008-2010年3月全国及主要省份半导体分立器件产量分析
三、2008年国内半导体分立器件的发展热点
四、我国半导体分立器件进出口分析
五、以新思维发展半导体分立器件产业
六、半导体分立器件未来的三大发展特点
第二节　“十一五”期间半导体集成电器发展概况
一、集成电路产业的发展状况
二、我国各地区半导体集成电路发展概况
三、半导体集成电路发展需创新
四、集成电路产业的错位竞争策略
五、2011年我国集成电路产业规模将突破1万亿元
第三节　“十一五”期间LED产业发展概况
一、LED在我国的发展
二、中国LED产业形成新格局
三、中国LED市场混乱
四、半导体照明LED产业前途光明
五、2010年我国LED产业产值预测

第七章　“十一五”期间中国半导体材料氮化镓发展情况分析
第一节　“十一五”期间第三代半导体材料相关介绍
一、第三代半导体材料的发展历程
二、第三代半导体材料得到推广
三、宽禁带半导体材料
第二节　“十一五”期间氮化镓的发展概况
一、氮化镓半导体材料市场的发展状况

二、氮化镓照亮半导体照明产业
三、GaN蓝光产业的重要影响
第三节　“十一五”期间氮化镓的研发和应用状况
一、中科院研制成功氮化镓基激光器
二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化
三、非极性氮化镓材料的研究有进展
四、氮化镓的应用范围
五、氮化镓晶体管的应用分析

第八章　“十一五”期间中国其他半导体材料市场发展概况分析
第一节　“十一五”期间砷化镓市场发展概况
一、砷化镓单晶材料的发展
二、砷化镓的特性
三、砷化镓产业的发展应用状况
四、我国最大的砷化镓材料生产基地投产
第二节　“十一五”期间碳化硅发展概况
一、半导体材料碳化硅介绍
二、碳化硅材料的特性
三、高温碳化硅制造装置的组成
四、我国碳化硅的研发与产业化项目取得重大突破

第九章　“十一五”期间中国半导体材料重点企业竞争力分析
第一节 有研半导体材料股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第二节 天津中环半导体股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第三节 浙江海纳科技股份有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第四节 峨眉半导体材料厂
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第五节 洛阳中硅高科有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第六节 北京国晶辉红外光学科技有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析

第七节 北京中科镓英半导体有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第八节 上海九晶电子材料有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第九节 东莞钛升半导体材料有限公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第十节 河南新乡华丹电子有限责任公司
一、企业概况
二、企业主要经济指标分析
三、企业盈利能力分析
五、企业偿债能力分析
四、企业运营能力分析
六、企业成长能力分析
第十一节 略…………

第十章 “十二五”期间世界及我国经济预测分析
第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势

一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
六、“十二五”期间美元地位继续削弱
七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
四、“十二五”期间我国产业体系预测
五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
六、“十二五”期间我国经济国家化预测
七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测

第十一章 “十二五”期间我国政策体系预测分析
第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
一、大消费
二、高铁及城轨建设
三、生产性服务
四、战略新兴产业
第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策

二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变

第十二章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策分析
第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
一、经济结构失衡
二、产业结构面临的问题
三、资本泡沫过度膨胀
四、收入差距进一步扩大
五、通货膨胀风险加剧
六、生态环境总体恶化趋势未改
第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
一、世界政治、经济格局的新变化
二、国际竞争更加激烈
三、投资的作用将下降
四、第三产业对经济增长的作用显著增加
五、迫切需要解决深层次体制机制问题
六、劳动力的供给态势将发生转折

第十三章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策分析
第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制

二、培育多极带动的国土空间开发格局
三、积极开展全方位多层次的区域合作
四、创新各具特色的区域发展模式
五、建立健全区域利益协调机制
第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
一、空间无序开发问题依然比较突出
二、东中西产业互动关系有待进一步加强
三、落后地区发展仍然面临诸多困难
四、财税体制尚需完善
五、区际利益矛盾协调机制不健全
第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
一、编制全国性的空间开发利用规划
二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
三、制定基础产业布局战略规划
四、加紧制定促进区域合作的政策措施

第十四章　“十二五”期间中国半导体材料的发展趋势与前景预测分析
第一节　“十二五”期间半导体产业的前景分析
一、我国半导体产业前景光明
二、2010年我国大陆将占世界半导体市场1/3
三、半导体设备业前景分析
四、半导体技术发展的低耗能趋势
第二节　“十二五”期间半导体材料产业的发展趋势分析
一、2010年全球半导体材料市场预测
二、2011年世界半导体材料市场规模预测
三、半导体材料的发展趋势
四、2010年化合物半导体材料市场预测
五、半导体清模材料的发展趋势
六、利用半导体材料开发新能源的前景
七、2010-2015年半导体材料产业发展预测

第十五章　“十二五”期间我国半导体产业面临的问题及对策分析

第一节　“十二五”期间我国半导体发展存在的问题
一、我国半导体产业发展面临的瓶颈
二、核心技术缺失阻碍中国半导体产业发展
三、我国半导体产业材料和设备严重滞后
四、我国半导体产业面临的挑战
第二节　“十二五”期间中国半导体发展的策略
一、我国半导体产业应主动参与海外收购
二、应尽快同步发展半导体支撑材料配套业
三、我国半导体产业追求创新与创收双赢
第三节　“十二五”期间我国半导体材料发展中存在的问题及建议
一、新材料产生的污染问题
二、我国半导体材料业应开拓创新
三、发展我国半导体材料的几点建议
第四节　“十二五”期间半导体硅材料发展中的问题
一、技术落后阻碍半导体硅材料发展
二、六大问题制约高纯硅材料产业发展
三、多晶硅价格居高不下给国内企业带来压力
第五节　“十二五”期间半导体硅材料的发展对策
一、加快半导体硅材料行业发展的建议
二、发展硅材料行业的策略
三、国内硅材料企业的竞争策略

图表目录：（部分）

图表：十二五规划重点政策倾斜内容预测
图表：2010年部分中央领导人在省部级干部贯彻科学发展观加快经济发展方式转变研讨班的讲话
图表：城镇化和战略性新兴产业是加快转变经济发展方式的重点
图表：房地产投资需求拉动多个行业发展
图表：中国区域发展阶段差异概况
图表：金融危机以来中国出台的区域规划
图表：2008年我国各省城市化率与人均GDP的对数曲线关系
图表：城市化进程的三个阶段

图表：不同城市化阶段及其特征
图表：2010-2015我国城市化水平预测
图表：国家战略化战略格局维度布局
图表：2010-2015各省城市化率变化情况
图表：“十二五”时期各省市城市化率变动及城市化带动的投资空间分布
图表：美国经济刺激计划中的绿色投资
图表：主要国家经济刺激计划中的绿色投资
图表：主要耗能设施的生命周期
图表：不同领域对减排的贡献
图表：“十一五”各行业营收增长
图表：“十一五”各行业盈利增长
图表：“十一五”各行业ROE提升
图表：“十一五”各行业市场表现
图表：“十二五”规划预期重点及措施
图表：历次五年规划主要任务目标及实现情况
图表：“一五”至“十一五”中国经济发展
图表：“十二五”时期战略性新兴产业七大领域
图表：2020年电源预计规模
图表：低碳技术创新和应用的路线图
图表：动力电池成本的国际比较
图表：我国动力电池技术与国际水平比较
图表：中国90年代以来城镇居民家庭消费支出结构变化趋势
图表：有研半导体材料股份有限公司主要经济指标走势图
图表：有研半导体材料股份有限公司经营收入走势图
图表：有研半导体材料股份有限公司盈利指标走势图
图表：有研半导体材料股份有限公司负债情况图
图表：有研半导体材料股份有限公司负债指标走势图
图表：有研半导体材料股份有限公司运营能力指标走势图
图表：有研半导体材料股份有限公司成长能力指标走势图
图表：天津中环半导体股份有限公司主要经济指标走势图
图表：天津中环半导体股份有限公司经营收入走势图
图表：天津中环半导体股份有限公司盈利指标走势图

图表：天津中环半导体股份有限公司负债情况图
图表：天津中环半导体股份有限公司负债指标走势图
图表：天津中环半导体股份有限公司运营能力指标走势图
图表：天津中环半导体股份有限公司成长能力指标走势图
图表：浙江海纳科技股份有限公司主要经济指标走势图
图表：浙江海纳科技股份有限公司经营收入走势图
图表：浙江海纳科技股份有限公司盈利指标走势图
图表：浙江海纳科技股份有限公司负债情况图
图表：浙江海纳科技股份有限公司负债指标走势图
图表：浙江海纳科技股份有限公司运营能力指标走势图
图表：浙江海纳科技股份有限公司成长能力指标走势图
图表：峨眉半导体材料厂主要经济指标走势图
图表：峨眉半导体材料厂经营收入走势图
图表：峨眉半导体材料厂盈利指标走势图
图表：峨眉半导体材料厂负债情况图
图表：峨眉半导体材料厂负债指标走势图
图表：峨眉半导体材料厂运营能力指标走势图
图表：峨眉半导体材料厂成长能力指标走势图
图表：洛阳中硅高科有限公司主要经济指标走势图
图表：洛阳中硅高科有限公司经营收入走势图
图表：洛阳中硅高科有限公司盈利指标走势图
图表：洛阳中硅高科有限公司负债情况图
图表：洛阳中硅高科有限公司负债指标走势图
图表：洛阳中硅高科有限公司运营能力指标走势图
图表：洛阳中硅高科有限公司成长能力指标走势图
图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司主要经济指标走势图
图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司经营收入走势图
图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司盈利指标走势图
图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司负债情况图
图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司负债指标走势图
图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司运营能力指标走势图
图表：北京国晶辉红外光学科技有限公司成长能力指标走势图

图表：北京中科镓英半导体有限公司主要经济指标走势图
图表：北京中科镓英半导体有限公司经营收入走势图
图表：北京中科镓英半导体有限公司盈利指标走势图
图表：北京中科镓英半导体有限公司负债情况图
图表：北京中科镓英半导体有限公司负债指标走势图
图表：北京中科镓英半导体有限公司运营能力指标走势图
图表：北京中科镓英半导体有限公司成长能力指标走势图
图表：上海九晶电子材料有限公司主要经济指标走势图
图表：上海九晶电子材料有限公司经营收入走势图
图表：上海九晶电子材料有限公司盈利指标走势图
图表：上海九晶电子材料有限公司负债情况图
图表：上海九晶电子材料有限公司负债指标走势图
图表：上海九晶电子材料有限公司运营能力指标走势图
图表：上海九晶电子材料有限公司成长能力指标走势图
图表：东莞钛升半导体材料有限公司主要经济指标走势图
图表：东莞钛升半导体材料有限公司经营收入走势图
图表：东莞钛升半导体材料有限公司盈利指标走势图
图表：东莞钛升半导体材料有限公司负债情况图
图表：东莞钛升半导体材料有限公司负债指标走势图
图表：东莞钛升半导体材料有限公司运营能力指标走势图
图表：东莞钛升半导体材料有限公司成长能力指标走势图
图表：河南新乡华丹电子有限责任公司主要经济指标走势图
图表：河南新乡华丹电子有限责任公司经营收入走势图
图表：河南新乡华丹电子有限责任公司盈利指标走势图
图表：河南新乡华丹电子有限责任公司负债情况图
图表：河南新乡华丹电子有限责任公司负债指标走势图
图表：河南新乡华丹电子有限责任公司运营能力指标走势图
图表：河南新乡华丹电子有限责任公司成长能力指标走势图

通过《2011-2015年中国半导体材料深度分析与“十二五”发展趋势预测报告》，生产企业及投资机构将充分了解产品市场、原材料供应、销售方式、市场供需、有效客户、潜在客户等详实信息，为研究竞争对手的市场定位，产品特征、产品定价、营销模式、销售

网络和企业发展提供了科学决策依据。

详细请访问：http://www.bosidata.com/xincailiao1105/A150437TAJ.html